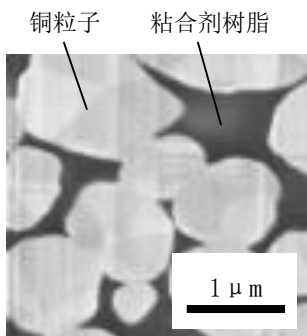


可焊锡铜浆 ELTRACE CP-901AN

ELTRACE CP-901AN是一种适用于丝网印刷的氮气固化型铜浆，其特点是具有优越的烧结性，导热性及焊锡润湿性。在铜浆布线上可以焊装电子部件，所以可作为铜箔的替代品使用。

特点① 烧结性

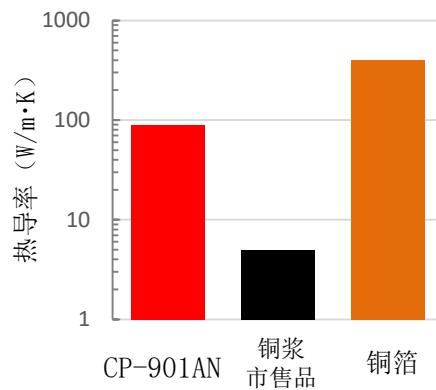
CP-901AN在氮气中加热至250℃以上，铜粒子之间进行烧结。因此，导电性、导热性优越。



铜浆固化膜截面SEM像

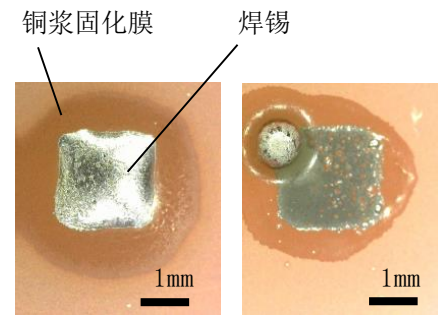
特点② 导热性

从CP-901AN得到的固化膜表现出优越的导热性。适用于重视散热性的电子部件的接合。



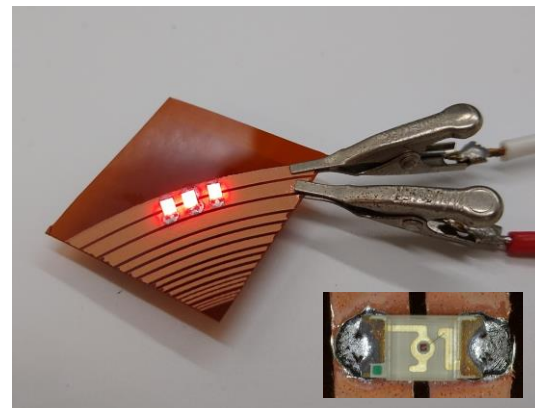
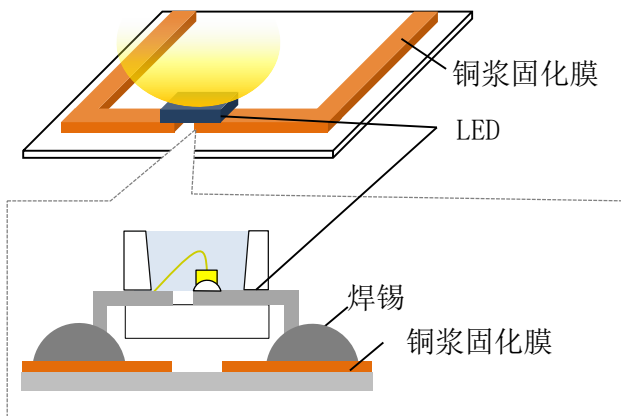
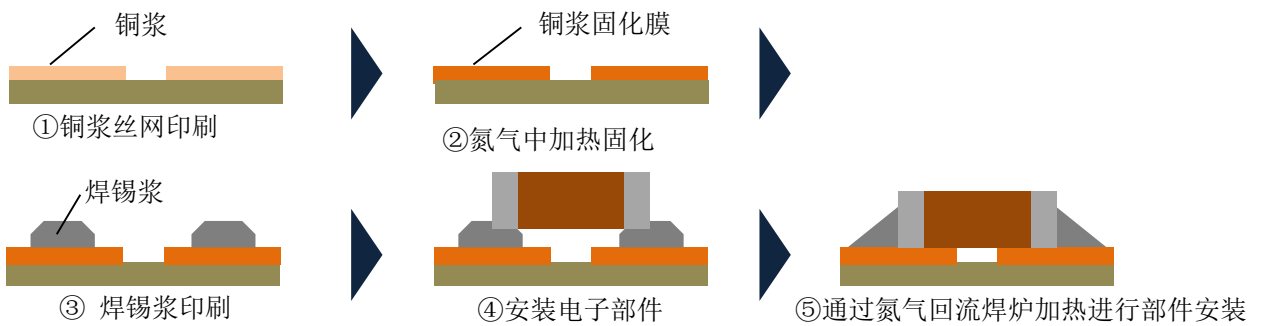
特点③ 焊锡润湿性

从CP-901AN得到的固化膜的焊锡润湿性良好。可以在铜浆固化膜上焊装电子部件。



CP-901AN 本公司传统产品

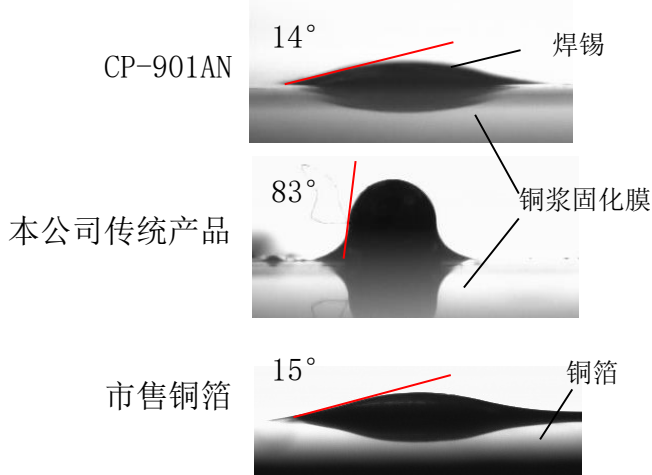
铜浆的使用示例



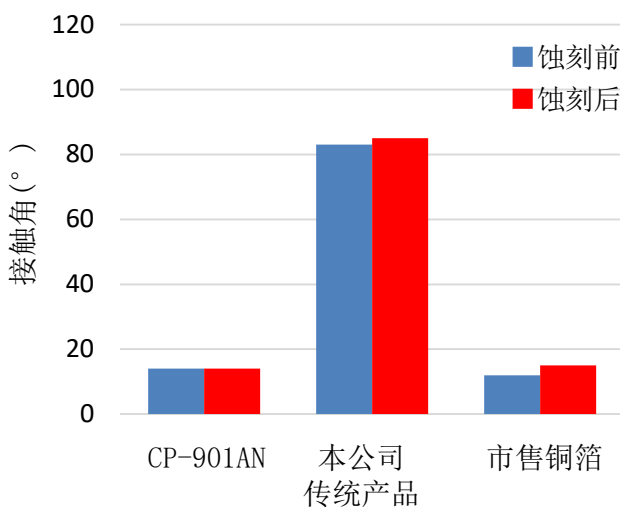
LED设备器件制作示例

焊锡润湿性

ELTRACE CP-901AN在150°C×16小时的蚀刻处理后，也展现出与市售的铜箔同等的焊锡润湿性。



锡焊润湿性试验后的接触角测量结果



一般特性

项目	试验条件	测量值
粘度	E型粘度计, 25°C, 5rpm	10~50 Pa·s
体积电阻率	建议固化条件 250°C×15min (N ₂) 300°C×15min (N ₂) 350°C×15min (N ₂)	10 μΩ·cm 7 μΩ·cm 5 μΩ·cm
焊接接合强度	螺柱销垂直拉伸试验 焊锡: Sn-3.0Ag-0.5Cu	5 MPa
热导率	周期加热法, 厚度方向	80~100 W/m·K

耐久性

项目	试验条件	结果
耐高温高湿性	85°C×85%RH×1,000 h	体积电阻率变化<10%
耐热性	128°C×240 h	
耐冷热冲击性	-40°C, 1 min⇔100°C, 2min, 2,000 cycle	无脱落
耐迁移性	85°C×85%RH×DC50 V 1,000 h L/S: 318/318 (μm)	无短路

记载内容是我们根据截止到目前所获得的资料, 信息, 数据制作而成的, 关于记载的数据, 评价, 危险及有害性等, 我们不做任何保证。另外, 因为记载事项是以通常情况的处理为对象, 所以在做特别处理时, 请在采取符合用途, 用法的安全对策之后再进行处理。



日油株式会社
油化事业部

联系方式

总公司 邮编〒150-6019 东京都涉谷区惠比寿4-20-3 (惠比寿Garden Place Tower)
TEL.03-5424-6694 FAX.03-5424-6810 E-mail.conductivepaste@nof.co.jp

2022.9(Ver.1)